JFP MPS Manual Placer System



The machines which require minimal training to operate

MPS EPOXY DIE BONDER Made in France

高精度での

小型チップ&SMD部品アセンブリを実現!



MPSを使用すれば、デリケートなデバイスの正確なピック &プレースが実現できます。

真空引きモジュール内蔵型のツールホルダ、及びロック ヘッドシステムは、簡単にチップ実装を行うソリューションを 提供しています。

ウルトラHDカメラ対応のビデオインターフェース、デジタル ズーム機能を装備し、小さなサイズから大きなサイズまで の対象物に柔軟に対応します。

フリップビジョンによるアライメントと、真の垂直Zモーション によって、高精度のチップ実装を実現します。

角度調整可能なサイドカメラによって、チップ実装直前の 状態を観察することができます。

MPSは、どなたでも簡単に操作できることを念頭に設計 されていますので、特別な訓練をする必要がありません。

MPSは、チップと小型SMD実装に最適なプラットフォームを提供します。

- 研究開発、試作などのプロトタイプ製作
- 小型部品の実装
- エポキシディスペンサ装備可
- はんだペーストスタンピング
- SMDリフロー
- 共晶ダイボンディング など

SYSTEM

- とてもコンパクトな卓上型装置
- Zモーション:安全な手動ドライブシステム
- 真の垂直動作
- ウルトラHDカメラによる、真の垂直ビジョン
- ソフトタッチダウン
- ヘッド下スペース:200mm、大型基板にも対応

DIE & SUBSTRATE

- 対応最小チップサイズ: 100 x 100 μm
- 真空引きモジュール内蔵型ピックアップツールホルダ
- 対応基板サイズ:350 mm
- ワッフルパック、ジェルパックなどにも対応可

Workholder Stage

- 手動式
- マイクロメータ式ファインモーションXYステージ装備 分解能:1 µm、移動サイズ:25 x 25 mm
- θ(シータ)調整が容易なロータリー式ベース装備
- ワーク高さ: 100 mm、または 60 mm
- 高さ調整機構付きワークホルダ
- ワーキングエリア: 200 x 200 mm
- マルチステージ: チップピックアップ、チッププレース、 スキージ付きスタンピング用ディスク 選択可
- 加熱ステージ: Φ50 mm 選択可
- SMDリフロー用ホットガスオプション 選択可

画像処理装置

- **ビデオ式顕微鏡**: UHDカメラ (5 MP)
 - 視野:11 mmまで、ズーム機能搭載
- PC、ビジョンインターフェース、USB3.0
- 調整可能なデジタルクロスヘア表示
- 同軸照明、リング式照明 選択可
- フリップチップアライメント機能装備
- 画像オーバーレイによるフェースアップ実装
- 画像オーバーレイによるフェイスダウン実装 (オプションで対応可)

FEATURES/PARAMETERS

- 低ピックアップ荷重: < 5 g
- チップ実装時荷重: 最大 500 g
- ロック式ヘッド、ディスペンス、スタンピング切替
- 加熱式ワークホルダ 選択可

APPLICATIONS

- 研究開発、試作
- 宝飾品、時計、SMD、BGA など

TECHNICAL SPECIFICATION

- 電力:100 V、3 A
- 真空:チップピックアップ用真空ポンプ内蔵
- サイズ:

270 x 500 x 352 mm (W x D x H)

重量: 17 kg

ユニテンプジャパン株式会社 〒194-0013 東京都町田市原町田2-6-13 ベルストーク1 - 2階 TEL: 042-860-7890 FAX: 050-3730-8404

E-mail: sales@unitemp.jp Web-site: https://www.unitemp.jp/

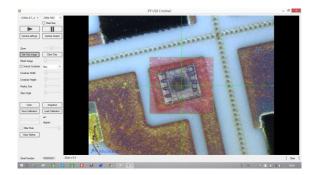
JFP MPS Manual Placer System



The machines which require minimal training to operate



MPS Options



ビデオビジョンアライメントシステム

- ビデオ式顕微鏡: UHDカメラ(5 MP)
 - 視野:11 mmまで、ズーム機能搭載
- PC、ビジョンインターフェース、USB3.0
- 画像オーバーレイによるフェースアップ実装 フリップチップオプション
- 画像オーバーレイによるフェースダウン実装



プロセスカメラ



ロッキングヘッド

- ディスペンサー スタンピング
- ピック&プレース
- 荷重調整機構
- Z軸動作: ソフト マニュアルドライブシステム



ワークステージ

- マイクロメータ式ファイン モーションXYステージ
- + 独自のチャック機構 高さ調整機構装備



- マルチワークホルダ1 ワッフルパック2 チップトレイス メー
 - 2 チップトレイ 2 x 2 インチ 高さ調整機構装備
 - 3 スタンピング用スキジー付き 回転皿



加熱式ワークホルダ(Φ50 mm) 最大到達温度:300℃ 高さ調整機構付き



ユニテンプジャパン株式会社 〒194-0013 東京都町田市原町田2-6-13 ベルストーク1 - 2階

TEL: 042-860-7890 FAX: 050-3730-8404 E-mail: sales@unitemp.jp Web-site: https://www.unitemp.jp/